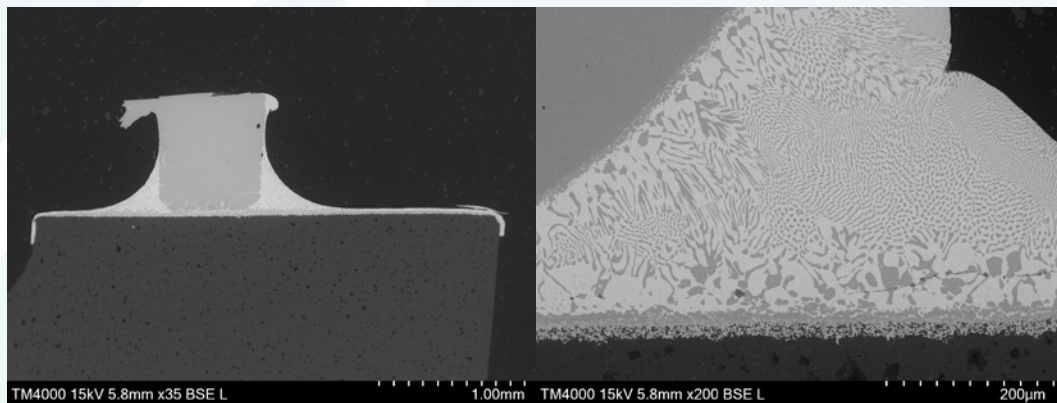


微电子器件焊接点的微观观察

在我们日新月异的生活中，一定少不了电子产品的身影，如今的电子产品向着微型化、薄型化和高可靠性的方向发展。由于微电子器件封装尺寸不断减小，在研发与检验时也需要设备可以看到更加的微观的结构。

如在传统的焊接技术中，很可能因忽略一些因素导致产品的不合格，通过使用扫描电子显微镜，可以看到因溶解、扩散、表面张力、应变等因素而产生的缺陷。

我们利用背散射电子可以看到焊接过程中，直观的看到焊点内部不同成分元素的分布及缺陷等问题，并对症下药，找到解决办法。



样品：微电子元件 仪器：TM4000 放大倍数：35x，200x